

## CMPドレッサー

# 15年度市場は微増に 海外3強がシェア堅持

CMPドレッサー(コンデイショナル)の2014年度(15年3月期)における世界市場は、前年度比9%増の120億円になったとみられる。為替の追い風もあったが、旺盛なデバイス需要でシリコンウエハーの投入枚数が増加し、近年苛烈だった価格下落にも一服感が強まったことがプラスに働いた。

15年度も堅調な需要が見込まれるものの、昨年ほどウエハー投入枚数の増加が見込めないことや、デバイス工場の稼働率の軟化などによって、伸びは小幅にとどまるもようだ。15年度市場は3%増の123億円と予測した。

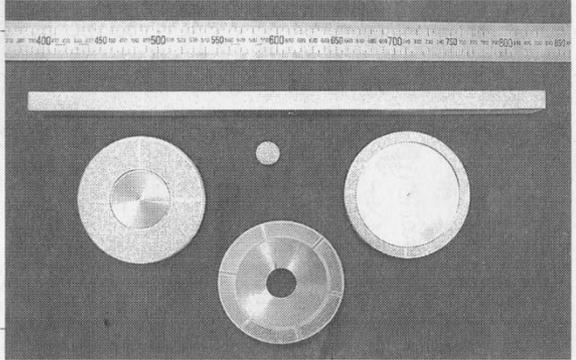
ドレッサーメーカーの世界シェアは、米国のスリーエム、台湾のKINIK(キニック)、韓国のセソルダイヤモンドがそれぞれ3割前後で拮抗しているとみられる。自国の強力な半導体メーカーに鍛えられ、そでの採用実績がシェア

に直結している。ほかに、セラミック基板上にダイアモンド砥粒をCVD結合させたCMPドレッサー「ブレナゲーム」を展開している

日本市場では、国内半導体メーカーに強い旭ダイヤモンド工業がトップシェアを獲得している

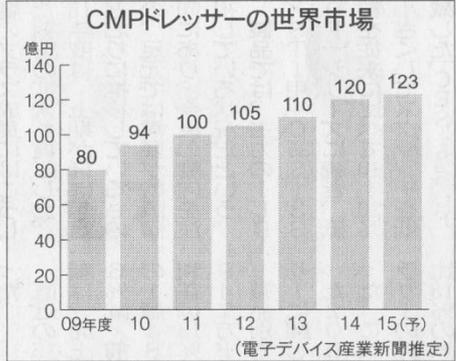
とみられるが、セソルとキニックが価格競争力や迅速な対応力を武器にシェアを伸ばしてきた。このほか

にアライドマテリアル、新日鉄住金マテリアルズ、スリーエム、ジャパン、ノリタケカンパニーリミテドなどが参入しているが、シェア構造は大きく変わっていない。



新日鉄住金マテリアルズのドレッサー製品群

はCVDで砥粒を保持する提案が出てきた。また、引き続きデバイスメーカーからの価格に対するプレッシャーが強いため、一般的なステンレス基材+ダイヤモンド砥粒という構成に限らず、樹脂基板を使ったものなど価格競争力が高い製品の増加もみられるようになってきた。



微細化に伴い、スクラップなどの欠陥への低減要求が年々厳しさを増しており、砥粒の脱落や欠けがないことは、もはや大前提。電着やロウ付け、焼結のほかに、最近で

厳しい競争のなかでドレッサー需要の増加が見込めるとすれば、製造プロセスの転換に伴うCMPステツプ数の増加、なかでも3D- NANDフラッシュの生産増に期待がかかる。サムスン電子に続き、東芝やマイクロンが予定どおり16年から量産を開始すれば、ドレッサーに限らずCMP消耗材全体の需要増につながる可能性がある。

### 各社の動向

#### セソルダイヤモンド(カイ)

韓国のセソルダイヤモンドは、韓国、中国で着実にシェアを伸ばし、世界トップ3をキープしている。日本市場でもスクラッチレス、低価格を武器に3割程度のシェアを維持している。

同社はマイクロスクラッチの低減とライフタイムを向上した製品をリリースしてきたが、今回、次世代用としてCVD法と新たな技術を使った「CLCタイプ」をリリース予定である。スクラッチフリーとロングライフを実現する。韓国での確認後、夏以降に日本でもリリース予定だ。

14年にリリースしたパツクラインディング、サファイアグラインディング、サファイアワイヤソーも生産能力の安定化を完了し、本格的に市場参入する。ちなみに、日本では(株)カイほか1社が販売している。カイは、CMPドレッサーのほかリテーナリング、パッド、CMP用フイルターも販売している。